Rec'd PCT/PTO 2 0 JUL 2004

DOCKET NO.: 255410US3PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Akira GOTO et al. SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP03/14898 INTERNATIONAL FILING DATE: November 21, 2003

FOR: INSULATION DISPLACEMENT CONNECTOR WITH BUILT-IN BOARD

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

COUNTRY	APPLICATION NO	DAY/MONTH/YEAR
Japan	2002-339688	22 November 2002
Japan	2002-339689	22 November 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP03/14898.

> Respectfully submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

C. Irvin McClelland Attorney of Record Registration No. 24,124 Surinder Sachar

Registration No. 34,423

Customer Number

22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 08/03)

10/502008 #2 PCT/JP03/14898

Rec'd PCT/PTO 2.0 JUL 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

08 1_2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年11月22日

出願番号 Application Number: 特願2002-339689

[ST. 10/C]:

[JP2002-339689]

RECEIVED 0 5 MAR 2004

WIPO PCT

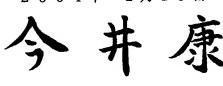
出 願 人
Applicant(s):

日本圧着端子製造株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 2月19日





【書類名】

特許願

【整理番号】

106360

【提出日】

平成14年11月22日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01R 13/00

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字丸根1099-25

日本圧着端子製造株式会社名古屋技術センター内

【氏名】

後藤 彰

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字丸根1099-25

日本圧着端子製造株式会社名古屋技術センター内

【氏名】

高木 義一

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字丸根1099-25

日本圧着端子製造株式会社名古屋技術センター内

【氏名】

宮原 和志

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字丸根1099-25

日本圧着端子製造株式会社名古屋技術センター内

【氏名】

千代田 恵

【特許出願人】

【識別番号】

390033318

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区南船場2丁目4番8号

【氏名又は名称】

日本圧着端子製造株式会社

【代理人】

【識別番号】

100075155

【弁理士】

【氏名又は名称】 亀井 弘勝

【選任した代理人】

【識別番号】

100087701

【弁理士】

稲岡 耕作 【氏名又は名称】

【選任した代理人】

【識別番号】

100101328

【弁理士】

【氏名又は名称】 川崎 実夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

010799

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

1 図面

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9722728

要

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板内蔵圧接コネクタ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被覆電線を圧接可能な圧接刃を有する本体およびこの本体から延設されるリードを含む圧接端子と、

上記リードを挿通させる挿通孔を有する底板、および底板上に形成され圧接端 子の本体を保持する端子保持部を含む主ハウジングと、

この主ハウジングの底板の挿通孔を挿通したリードが半田付けされた回路基板と、

主ハウジングと組み合わされ、主ハウジングとの間に圧接端子のための第1の 保持空間を区画する第1のカバーハウジングと、

主ハウジングと組み合わされ、主ハウジングとの間に上記回路基板のための第 2の保持空間を区画する第2のカバーハウジングとを備え、

この第2のカバーハウジングは、圧接端子の圧接荷重を主ハウジングの底板及 び回路基板を介して受けるための受け部を主ハウジングの端子保持部に対応する 位置に設けることを特徴とする基板内蔵圧接コネクタ。

【請求項2】

請求項1において、上記第2のカバーハウジングは、そのリブにより少なくとも一部が構成されるボックス状部を含み、このボックス状部に上記受け部が設けられることを特徴とする基板内蔵圧接コネクタ。

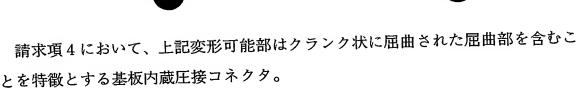
【請求項3】

請求項2において、上記主ハウジングの底板は、第2のカバーハウジングのリブとの間に回路基板を挟持することのできるリブを含むことを特徴とする基板内 蔵圧接コネクタ。

【請求項4】

請求項1,2又は3において、上記リードは上記圧接荷重により弾性変形可能 な変形可能部を含むことを特徴とする基板内蔵圧接コネクタ。

【請求項5】



【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、回路基板を内蔵するとともに電線を圧接により接続可能な基板内蔵 圧接コネクタに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、電気コネクタにおいて、コネクタハウジング内に保持した状態の圧接端 子を電線に圧接する技術がある(例えば特許文献1および特許文献2)。

また、回路基板を内蔵する電気コネクタが提供されている(例えば特許文献3および特許文献4)。

[0003]

【特許文献1】

実開平6-86261号公報

【特許文献2】

特開2000-285994公報

【特許文献3】

特開2001-297817号公報

【特許文献4】

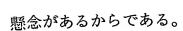
特開2002-67789号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、回路基板を内蔵する電気コネクタにおいて、該回路基板に半田付けされた状態の圧接端子をハウジング内で電線に圧接するものは、未だ提供されていない。

これは、ハウジング内で圧接する場合、圧接端子に負荷される圧接荷重によってハウジングが撓んだりして、回路基板への半田付け部分が負荷により破損する



[0005]

ところで、近年、自動車等の車両において、各種ECU (Electric Control Unit)間をネットワークで接続することが進んでいる。

例えば空調制御を司るメインのECUとエアコンのダクトのルーバの角度制御を司るECUとが共通の送り配線を介して電気的に接続される場合がある。

車種によって両ECU間の配線距離は様々であるので、電線への圧接をコネクタの組立の最終工程で実施することが好ましい。ところが、そうした場合、予め回路基板に半田付けされた圧接端子を電線に圧接させることになり、半田付け部分の破損等の問題が懸念される。

[0006]

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、回路基板を内蔵するコネクタにおいて、ハウジング内での圧接を実質的に可能とする基板内蔵圧接コネクタを提供することを目的とする。

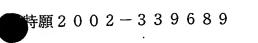
[0007]

【課題を解決するための手段及び発明の効果】

上記課題を解決するため、請求項1記載の発明は、被覆電線を圧接可能な圧接 刃を有する本体およびこの本体から延設されるリードを含む圧接端子と、上記リードを挿通させる挿通孔を有する底板、および底板上に形成され圧接端子の本体 を保持する端子保持部を含む主ハウジングと、この主ハウジングの底板の挿通孔 を挿通したリードが半田付けされた回路基板と、主ハウジングと組み合わされ、 主ハウジングとの間に圧接端子のための第1の保持空間を区画する第1のカバー ハウジングと、主ハウジングと組み合わされ、主ハウジングとの間に上記回路基 板のための第2の保持空間を区画する第2のカバーハウジングとを備え、この第 2のカバーハウジングは、圧接端子の圧接荷重を主ハウジングの底板及び回路基 板を介して受けるための受け部を主ハウジングの端子保持部に対応する位置に設 けることを特徴とするものである。

[0008]

本発明では、圧接端子の本体を主ハウジングの端子保持部に保持すると共に、



主ハウジングの底板を貫通させた圧接端子のリードを予め回路素子群が実装された回路基板に半田付けした後、主ハウジングに第2のカバーハウジングを組み付けて回路基板を第2の保持空間に保持し、サブアセンブリとする。このようなサブアセンブリの状態で、例えば送り配線としての被覆電線の所望の位置に圧接端子を圧接することができ、自在性が高い。特に、自動車等の車両の各種ECU間のLAN(Local Area Network)配線に好適に用いることができる。上記の圧接後、第1のカバーハウジングを主ハウジングに組み付ける。

[0009]

また、圧接荷重を、主ハウジングの底板及び回路基板を介して第2のカバーハウジングの受け部によって受け止めることができるので、底板や回路基板が不用意に撓んだりすることがなく、確実な圧接を達成することができる。これにより、基板内蔵圧接コネクタにおける、いわゆるハウジング内圧接が実質的に可能となった。

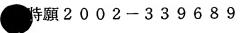
請求項2記載の発明は、 請求項1において、上記第2のカバーハウジングは、そのリブにより少なくとも一部が構成されるボックス状部を含み、このボックス状部に上記受け部が設けられることを特徴とする。本発明では、ボックス状部に設けた受け部によって圧接荷重をしっかりと受け止めて、確実な圧接を達成することができる。

[0010]

また、請求項3記載の発明は、請求項1又は2において、上記主ハウジングの 底板は、第2のカバーハウジングのリブとの間に回路基板を挟持することのでき るリブを含むことを特徴とする。本発明では、圧接荷重によって回路基板が不用 意に曲げられたりすることがない。

また、請求項4記載の発明は、請求項1又は2において、上記リードは上記圧接荷重により弾性変形可能な変形可能部を含むことを特徴とするものである。本発明では、圧接時に、万一、リードに負荷がかかったとしても、リードの変形可能部が変形することで、これを吸収することができ、半田付け部に不要な負荷が及ぼされることがない。

[0011]



また、請求項5記載の発明は、請求項4において、上記変形可能部はクランク 状に屈曲された屈曲部を含むことを特徴とするものである。本発明では、リード が簡単な構造にて確実に圧接時の負荷を吸収することができる。

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明の好ましい実施の形態について添付図面を参照しつつ説明する。

図1は本発明の一実施の形態の基板内蔵圧接コネクタの概略斜視図であり、図2は基板内蔵圧接コネクタの平面図である。図3は図2のIII ーIII 線に沿う断面図であり、図4は図2のIV-IV線に沿う断面図である。

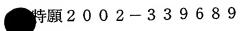
図1,図2及び図3を参照して、基板内蔵圧接コネクタ1 (以下では、単にコネクタ1ともいう)は、第1方向Xに延びる送り配線としての複数の被覆電線2の途中部をそれぞれ皮剥圧接する複数の圧接端子3 (図3では一つの圧接端子3のみを示す)と、圧接端子3の本体4を保持する端子保持部5を有する主ハウジング6と、主ハウジング6に対して互いに反対側(例えば上下)に組み合わされる第1及び第2のカバーハウジング7,8とを備える。

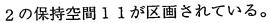
$[0\ 0\ 1\ 3\]$

図1を参照して、主ハウジング6は第1方向Xに沿って延びる第1の部分6 a と、第1方向Xと直交する第2方向Yに沿って延びる第2の部分6 b とを有する。主ハウジング6の第2の部分6 b の端部には、複数の開口90が横並びに配置されている。図4に示すように、各開口90の奥部の収容凹部91には、図示しない電線の端部に圧着された対応する雄端子を接続するための雌端子92が収容され保持されている。雌端子92の一端に設けられるリード93は、回路基板10の挿通孔94に挿通され、回路基板10の第1の面10aの導電部に半田付けされて、回路基板10との電気的な接続が達成されている。

[0014]

図3を参照して、互いに組み合わされた主ハウジング6の第1の部分6aと第1のカバーハウジング7との間に、圧接端子3および被覆電線2の所要部分を保持するための第1の保持空間9が区画されている。また、互いに組み合わされた主ハウジング6と第2のカバーハウジング8との間に、回路基板10のための第





圧接端子3の本体4からはリード12が延設されている。このリード12は、 主ハウジング6の底板13の挿通孔14を挿通して第2の保持空間11に延び、 さらに回路基板10の挿通孔15を挿通してその先端部が回路基板10の第1の 面10aの導電部に半田付けされている。

[0015]

図3および図4を参照して、16, 17はそれぞれ回路基板10の第1及び第2の面10a, 10bに実装されるコンデンサ等の素子である。

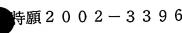
図3を参照して、主ハウジング6と第1のカバーハウジング7とが組み合わされた状態で、被覆電線2が第1の保持空間9を第1の方向Xに沿って貫通している。第1の保持空間9内において、被覆電線2の途中部は圧接端子3の本体4の圧接刃74に圧接されている。被覆電線2は、第1の方向Xに関して圧接端子3の本体4を挟んだ両側で第1のカバーハウジング7の対応する突出部分によってそれぞれ屈曲される第1および第2の屈曲部分19,20を有する。これらの屈曲部分19,20は被覆電線2に働く外部からの引抜き荷重が圧接端子3の圧接部分に及ぼされることを防止する。

[0016]

具体的には、主ハウジング6は、第1の方向Xに並ぶ同一高さの第1、第2および第3の電線保持部21,22,23を有している。各電線保持部21,22,23は例えば溝状をなし電線の本数に対応して複数が設けられる。第2および第3の電線保持部22,23は、第1の方向Xに関して、端子保持部5を挟んで第1の電線保持部21とは反対側に配置される。主ハウジング6は第2および第3電線保持部22,23の間に凹部24を設けており、第1のカバーハウジング7は凹部24に対応して凸部25を設けている。第2および第3の電線保持部22,23間の被覆電線2の部分が、凸部25によって凹部24内に押し込まれて屈曲されることにより、上記の第2の屈曲部分20が構成される。

[0017]

また、主ハウジング6は、第1の方向Xに関して第1の電線保持部21よりも外側に凹部26を設けており、第1のカバーハウジング7の端壁27が凹部26



に対応して設けられている。第1の電線保持部21から外側へ延びる被覆電線2 の部分が、第1のカバーハウジング7の端壁27によって、主ハウジング6の凹 部26内に押し込まれてクランク状に屈曲されることにより、クランク状に屈曲 される部分としての上記の第1の屈曲部分19が構成される。

[0018]

分解斜視図である図5を参照して、主ハウジング6の第1の部分6aには、第 2の方向Yに対向する各一対の壁部61,62が設けられており、各壁部61, 62には、第1のカバーハウジング7の側部の対応するフック63,64を引っ 掛け係合させるための例えば係合溝からなる係合部65,66が形成されている

これらのフック63、64を対応する係合部65、66に引っ掛け係合させた 状態で、第1のカバーハウジング7の下面7aに設けられる上記凸部25が凹部 24内へ被覆電線2の部分を押し込むわけである。また、第1のカバーハウジン グ7の端壁27は、例えば一対の第1の突起67と第1の突起67よりも突出量 の多い例えば一対の連結手段としての第2の突起68が突出形成される。

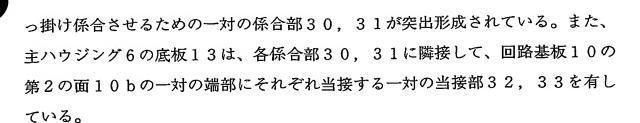
[0019]

第1のカバーハウジング7が主ハウジング6に組み合わされたときに、一対の 第1の突起67が、隣接する被覆電線2間に挿入されて主ハウジング6の凹部2 6の底部壁26aに当接すると共に、図2のVI-VI線に沿う断面図である図6に 示すように、一対の第2の突起68が主ハウジング6の凹部26の底部壁26a に形成される対応する一対の連結手段としての嵌合孔からなる嵌合部 6 9 にそれ ぞれ嵌合するようになっている。

[0020]

この嵌合により、第1のカバーハウジング7の端壁27が主ハウジング6に強 固に連結されるので、万一、被覆電線2に外部から引抜き荷重が働いても、上記 連結が外れることがない。いわゆる、第1のカバーハウジング7の端壁27のめ くれ上がりの防止である。

再び図3を参照して、主ハウジング6の底板13の、第1の方向Xに関する両 端部からは、第2のカバーハウジング8の一対のフック28,29をそれぞれ引



[0021]

図7に示すように、第2のカバーハウジング8は、矩形状をなす底壁34と、底壁34の周囲を取り囲む第1,第2,第3および第4の側壁35,36,37,38を有する。39,40は第1および第2の側壁35,36より外側に設けられる外部壁であり、各外部壁39,40の端部には、図3に示すように、上記のフック28,29がそれぞれ設けられる。

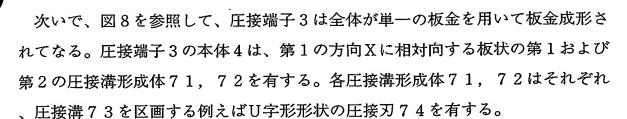
また、図7を参照して、底板34から、第1の側壁35に平行なリブ41と、第3の側壁37に平行なリブ42が立設されている。これらのリブ41,42と第1の側壁35と第4の側壁38とで、強度的に優れたボックス状部43が構成され、このボックス状部43に、後述する圧接荷重を回路基板10を介して受けるための受け部44が設けられる。受け部44は、第1の側壁35と各リブ41,42の端面により構成され、図3に示すように、回路基板10の第1の面10aに当接する。圧接端子3のリード12の先端12aは、ボックス状部43に囲まれる回路基板12の領域を挿通する。

[0022]

図3を参照して、第1の方向Xに離間する第1および第2の側壁35,36の 各端部が、対応する主ハウジング6の当接部32,33との間に回路基板10の 対応する端部を挟持する。

また、主ハウジング6の底板13には、回路基板10の第2の面10bに実装される、回路素子17を含む回路素子群を収容するための凹部45が形成されており、この凹部45の一部には、回路基板10の第2の面10bに当接するリブ46が立設されている。このリブ46は、第2のカバーハウジング8のリブ41に概ね対応する位置に配置され、両リブ46,41の間に回路基板10を挟持することができるようになっている。

[0023]



第1および第2の圧接溝形成体71,72の底部73a,73b間は連結部75により連結されている。また、第1および第2の圧接溝形成体71,72の底部73a,73bの両側縁には、主ハウジング6の端子保持部5に係止するための係止部としての係止突起76,77が側方へ突出形成されている。図9に示すように、各係止突起76,77は、主ハウジング6の端子保持部5に形成される対応する縦溝83,84内に圧入されて係止される。

[0024]

再び図3を参照して、第1の圧接溝形成体71の両側縁からそれぞれ一対の板部78,79が折り曲げ形成されている。これらの板部78,79は互いの間に被覆電線2の保持空間Rを形成するためのものである。

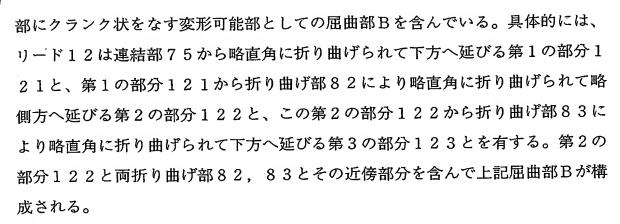
各板部 7 8 , 7 9 の下縁 7 8 a , 7 9 a は端子保持部 5 の底部 5 a に当接して受けられるようなっている。各板部 7 8 , 7 9 の下縁 7 8 a , 7 9 a からは主ハウジング 6 の端子保持部 5 に係止するための例えばフック状をなす係止部としての係止突起 8 0 が下方へ突出形成されている。図 9 に示すように、各係止突起 8 0 は、主ハウジング 6 の端子保持部 5 に形成される係止孔 8 5 内に導入されて引っ掛け係止される。

[0025]

再び図3を参照して、各板部78,79の上縁78b,79bからは、それぞれ折り曲げ可能片81が上方へ突出形成されている。これらの折り曲げ可能片81は、互いに内側へ折り曲げられることにより、被覆電線2を上記保持空間に閉じ込めるためのものである。具体的には、保持空間Rは主ハウジング6の端子保持部5の対応する部分5bと、一対の板部78,79と上記の折り曲げ後の折り曲げ可能片81とによって区画されることになる。

[0026]

上記のリード12は上記の連結部75の一側縁から下方へ延設され、その中間



[0027]

図10に示すように、第1の部分121が主ハウジング6の挿通孔14に挿通され、第3の部分123が回路基板10の挿通孔15に挿通される。また、屈曲部Rは主ハウジング6の底板13と回路基板10との間に位置することになり、圧接時に変形して、圧接荷重がリード12の先端12aの半田付け部分Sに及ぼされることを防止することができる。

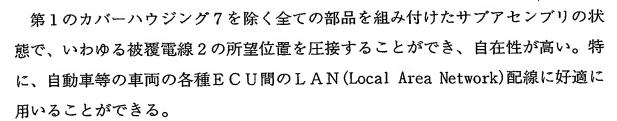
本実施の形態において、基板内蔵圧接コネクタ1を組み立てるに際しては、まず、図11(a)および(b)に示すように、各圧接端子3を主ハウジング6に組み付け、図9に示すように、圧接端子3の本体4を主ハウジング3の端子保持部5に上記の係止突起76,77,80を用いて固定すると共に、圧接端子3のリード12を主ハウジングの底板13の挿通孔14に挿通させて第2の保持空間11に進出させる。

[0028]

次いで、予め回路素子群が実装された回路基板10を第2の保持空間11に収容し、図10に示すように、回路基板10の挿通孔15に上記リード12を挿通させた後、リード12の先端12aを半田付けする。

次いで、主ハウジング6に第2のカバーハウジング8を組み付けて回路基板10を第2の保持空間11に保持し、サブアセンブリとする。このようなサブアセンブリの状態で、例えば送り配線としての被覆電線2の所望の位置に圧接端子3を圧接する。圧接後は、第1のカバーハウジング7を主ハウジング6に組み付け、基板内蔵圧接コネクタ1の組立が完了する。

[0029]



特に、圧接荷重を、主ハウジング6の底板13及び回路基板10を介して第2のカバーハウジング8の受け部44によって受け止めることができるので、底板13や回路基板10が不用意に撓んだりすることがなく、確実な圧接を達成することができる。これにより、基板内蔵圧接コネクタにおける、いわゆるハウジング内圧接が実質的に可能となった。

[0030]

また、上記の圧接時の荷重を受けるための受け部44を、図7に示すように第 2のカバーハウジング8の強度的に優れたボックス状部43に設けているので、 圧接荷重をしっかりと受け止めて、確実な圧接を達成することができる。

また、図3に示すように、主ハウジング6の底板13のリブ46と第2のカバーハウジング8のリブ41との間に回路基板10を挟持するので、圧接荷重によって回路基板10が不用意に曲げられたりすることを確実に防止できる。

[0031]

さらに、圧接時に、万一、リード12に負荷がかかったとしても、図10に示すように、リード12のクランク状をなす屈曲部Bが弾性変形することで、これを吸収できるので、半田付け部分Sに不要な負荷が及ぼされることがない。リード12に設ける簡単な構造にて確実に圧接時の負荷を吸収することができる。

なお、図8の実施の形態の圧接端子3では、第1の圧接溝形成体71からのみ、板部78,79を延設したが、これに限らず、図12に示すように、第2の圧接溝形成体72からも保持空間Rを区画するための板部78,79を折り曲げ状に延設することができる。この場合、被覆電線2をより確実に保持することが可能となる。

[0032]

その他、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の特許請求の範囲で種々の変更を施すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態の基板内蔵圧接コネクタの概略斜視図である。

【図2】

基板内蔵圧接コネクタの平面図である。

【図3】

図2のIII -III 線に沿う断面図である。

【図4】

図2のIV-IV線に沿う断面図である。

【図5】

基板内蔵圧接コネクタの分解斜視図である。

【図6】

図2のVI-VI線に沿う断面図である。

【図7】

第2のカバーハウジングの斜視図である。

【図8】

圧接端子の斜視図である。

【図9】

基板内蔵圧接コネクタの要部の模式的断面図であり、主ハウジングの端子保持 部に圧接端子を保持した状態を示す。

【図10】

基板内蔵圧接コネクタの要部の模式的断面図であり、主ハウジングの端子保持 部に保持された圧接端子のリードが回路基板に半田付けされた状態を示す。

【図11】

(a) および(b) は圧接端子の組み付け工程を示す斜視図である。

【図12】

圧接端子の変更例を示す斜視図である。

【符号の説明】

1 基板内蔵圧接コネクタ

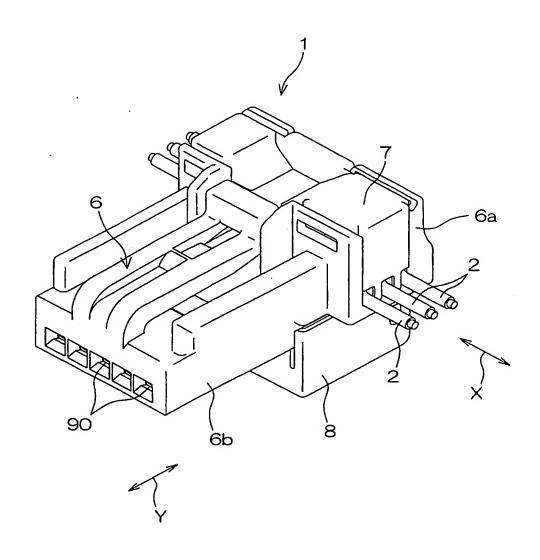
- 2 被覆電線
- 3 圧接端子
- 4 本体
- 5 端子保持部
- 6 主ハウジング
- 7 第1のカバーハウジング
- 8 第2のカバーハウジング
- 9 第1の保持空間
- 10 回路基板
- 10a 第1の面
- 10b 第2の面
- 11 第2の保持空間
- 12 リード
- 13 底板
- 14 挿通孔
- 41, 42 リブ
- 43 ボックス状部
- 4 4 受け部
- 46 リブ
- 71 第1の圧接溝形成体
- 72 第2の圧接溝形成体
- 73 圧接溝
- 7 4 圧接刃
- 75 連結部
- 76,77 係止突起
- 78,79 板部
- 80 係止突起
- 81 折り曲げ可能片
- R 保持空間

B 屈曲部(変形可能部)

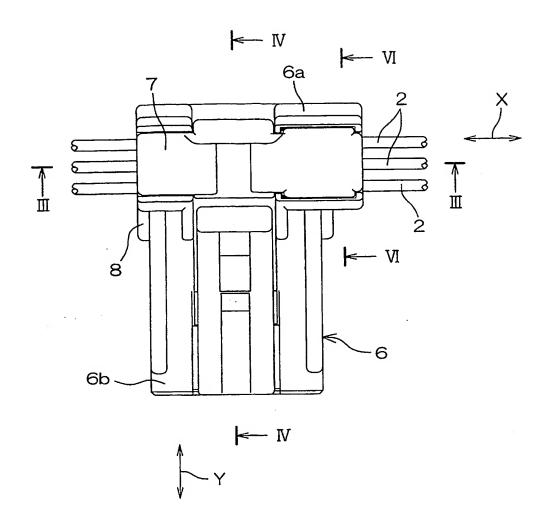
【書類名】

図面

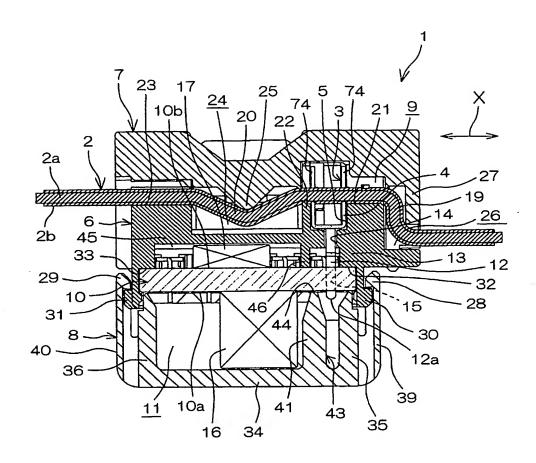
【図1】



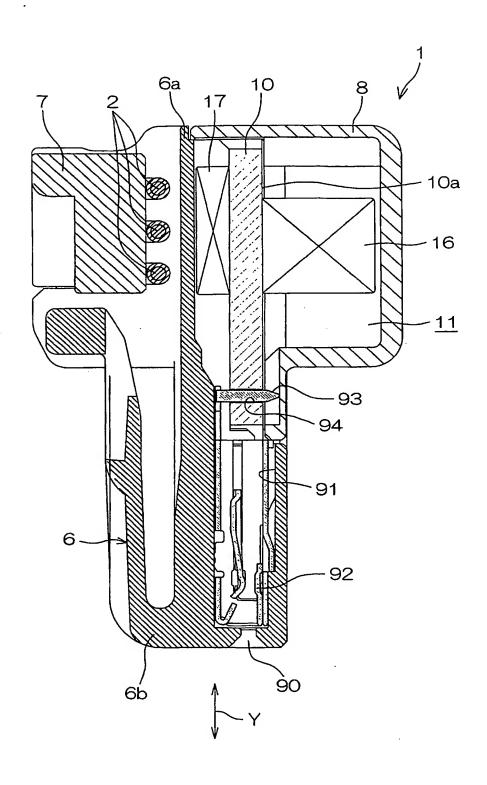




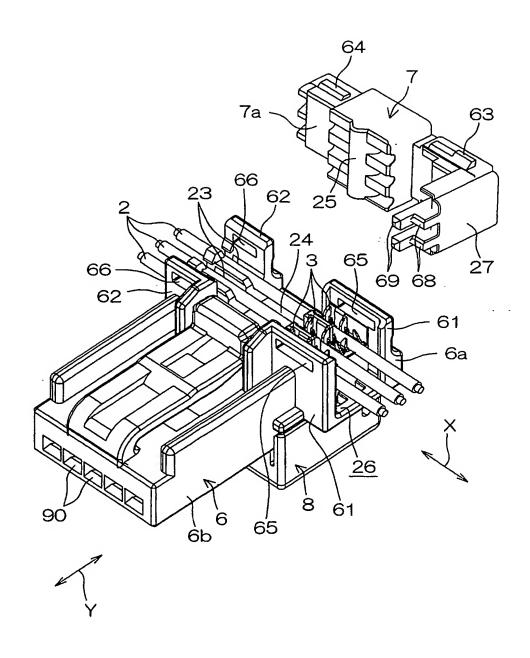




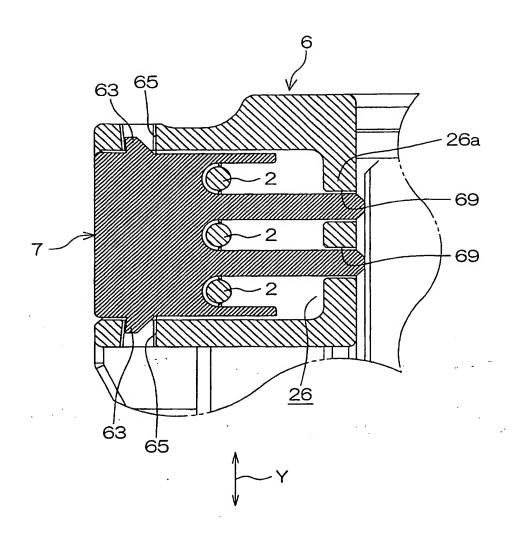




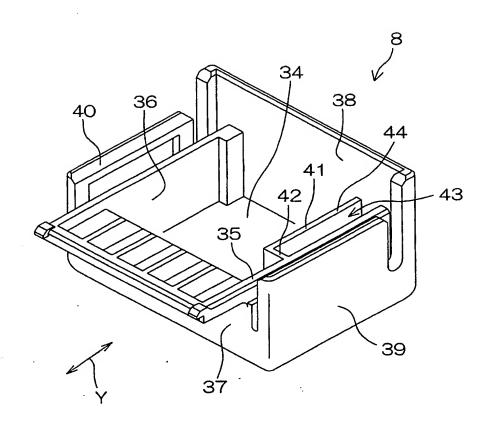




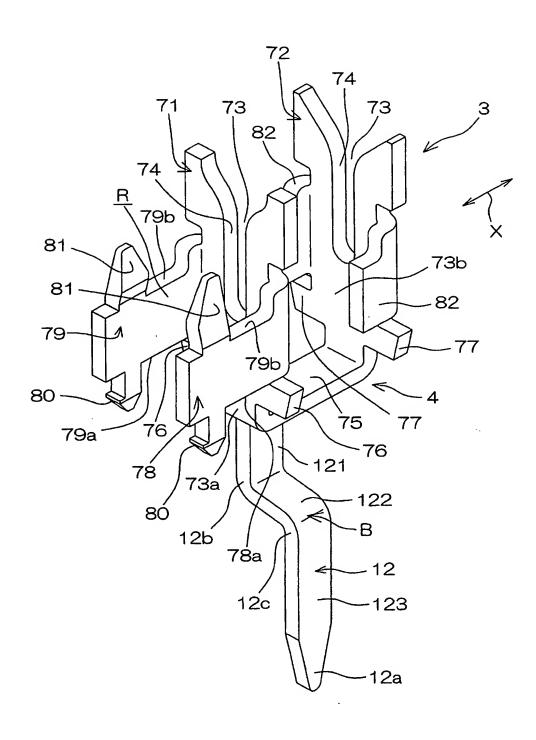
【図6】



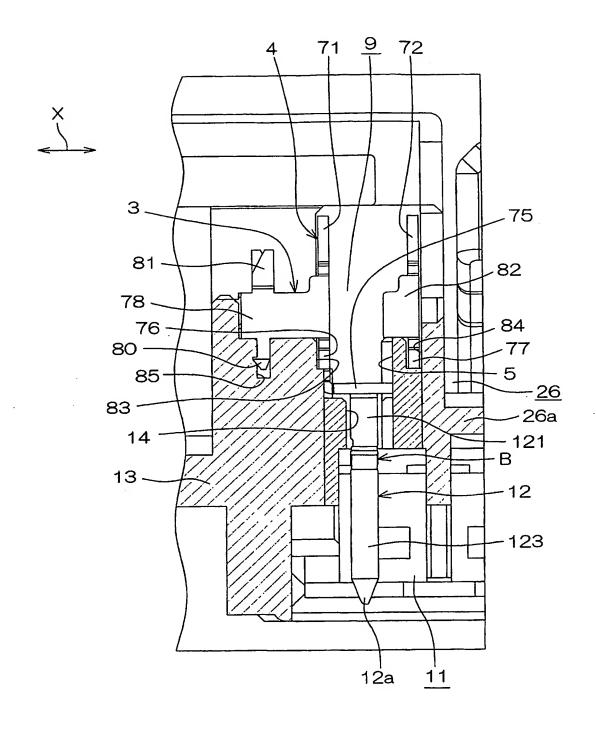




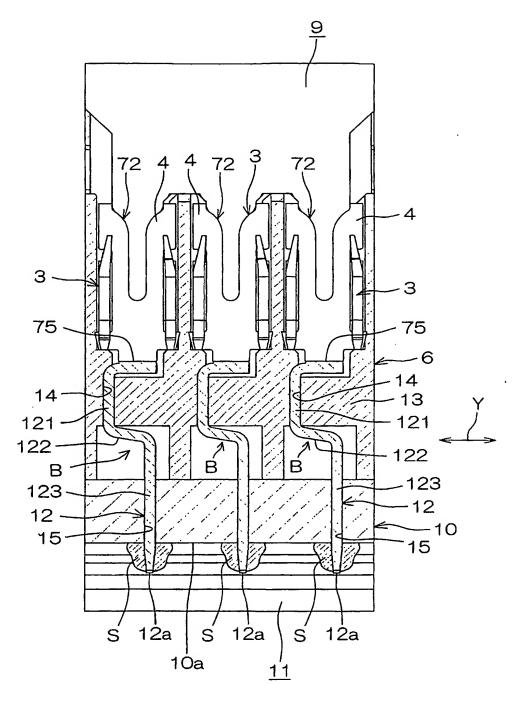




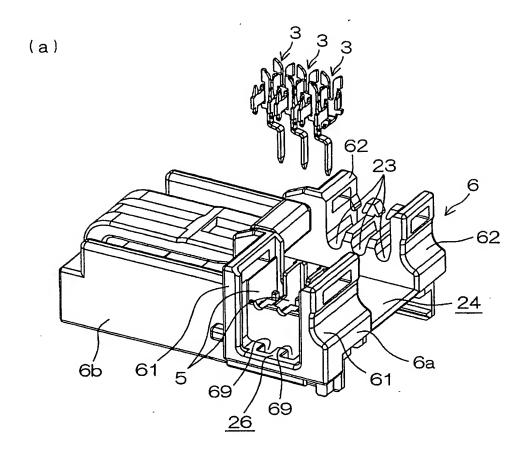


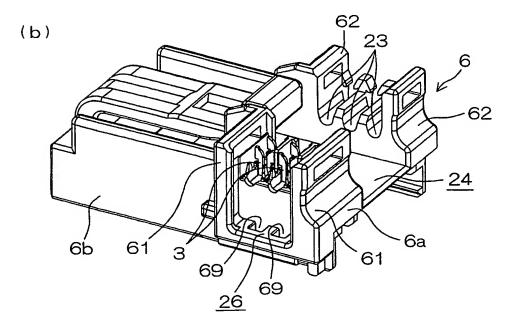




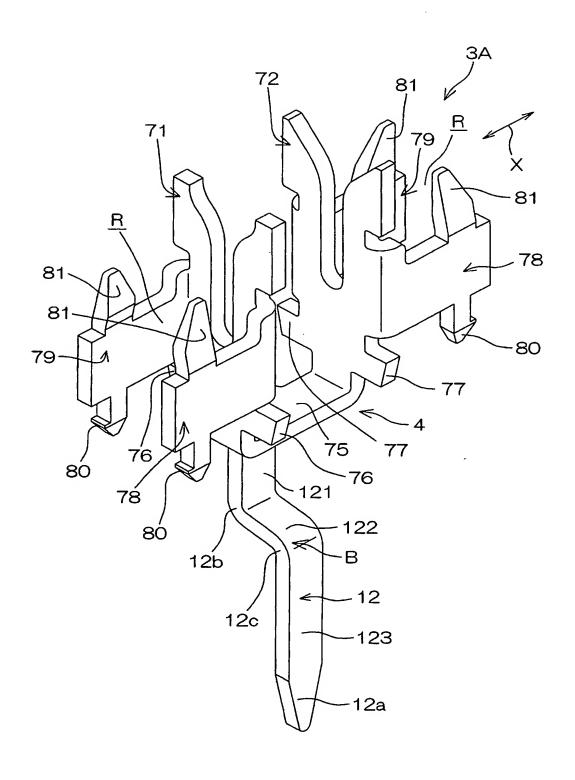


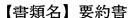












【要約】

【課題】回路基板を内蔵するコネクタにおいて、回路基板に半田付けされた 圧接端子についてハウジング内での圧接を実質的に可能とすること。

【解決手段】圧接端子3を主ハウジング6の端子保持部5に保持する。圧接端子3のリード12が主ハウジング6の底板13および回路基板10を貫通して回路基板10の第1の面10aに半田付けされ、回路基板10が主ハウジング6と第2のカバーハウジング8との間の第2の保持空間11に保持される。このようなサブアセンブリの状態で、被覆電線2の所望の位置に圧接端子3を圧接した後、第1のカバーハウジング7を主ハウジング6に組み付ける。圧接荷重を、主ハウジング6の底板13及び回路基板10を介して第2のカバーハウジング8の受け部44によって受ける。底板13や回路基板10が不用意に撓んだりせず、確実な圧接を達成でき、いわゆるハウジング内圧接が実質的に可能となる。

【選択図】 図3

特願2002-339689

出願人履歴情報

識別番号

[390033318]

1. 変更年月日

1990年11月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区南船場2丁目4番8号

氏 名

日本圧着端子製造株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.